

Track, Trace, Sense: AutoID-Technologien für die Digitalisierung von Verpackungs- und Logistik-Prozessen

Donnerstag / 27.09.2018 / 12.00-14.00 Uhr

Forum „TechBox“: Halle 4

(Stand: 07.06.2018 / Änderungen vorbehalten)

AIM unterstützt als Kompetenzpartner für die AutoID-Technologien die **FachPack 2018** und zeigt dabei auf, welche Rolle diese Technologien als *Enabling Technologies* für die Digitalisierung der Wertschöpfung leisten. Und Industrie 4.0 fängt weder in der Produktion an, noch hört Industrie 4.0 in der Produktion auf: Logistik 4.0 denkt die Ansätze von Industrie 4.0 weiter und ist integraler Bestandteil dieses Konzepts – und dabei spielt u.a. der Bereich der Verpackung, Verpackungsmaschinen und -Prozesse eine essenzielle Rolle, die viele AIM-Mitgliedsunternehmen schon lange professionell begleiten.

Programm:

12.00 Uhr: Einführung und Moderation

Peter Altes, Geschäftsführer, AIM-D e.V., Lampertheim

12.05 Uhr: Vortrag-1:

AutoID- und Industrial IoT-Lösungen für Industrie 4.0-Szenarien in der Verpackungsindustrie

Referent: Prof. Dr. Dirk Reichelt, Group Manager Smart Wireless Production, Fraunhofer Institut für Photonische Microsysteme (IPMS), Dresden

12.25 Uhr: Vortrag-2:

IO-Link - die notwendige Voraussetzung für Industrie 4.0-Sensorik

Referent: Frank Schabe, Key Account Manager Fabrikautomation, Pepperl+Fuchs Vertrieb Deutschland GmbH, Wernau

12.45 Uhr: Vortrag-3:

Digitalisierung im Bestand: Nachrüstbare Sensorik-Lösungen für die Erfassung von Maschinenzuständen und zur vorausschauenden Wartung von Verpackungsmaschinen

Referent: Dr. Gerd vom Bögel, Leiter Geschäftsfeld „Wireless & Transponder Systems“ Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS), Duisburg

13.05 Uhr: Vortrag-4:

Produktionstop war gestern! – Die Digitalisierung im Nachschub: Trends und Praxisbeispiele: Automatisierte Materialversorgung in Industrie 4.0 unter Berücksichtigung von LEAN Production, IoT und Low-Energy-Technologien

Referent: Peter Schmidt, ITSchmidt, Köln

13.25 Uhr: Vortrag-5:

Gedruckte Elektronik für das Verpackungsmanagement: B2B (z.B.: Kühlkette) und B2C (z.B.: Premiumprodukte)

Referent: Dr. Martin Gutfleisch, Vice President Research & Development, Witte-Gruppe, Münster

13.45 Uhr: Fragen und Diskussion

13.50 Uhr: Ende des AIM-Forums